PC+ABS

Bayblend® T85 SF

科思创

编号 #112 · 金塑通参考目录 2026

Resin Overview

PC+ABS · 高流,结构泡泡. Sourced from public manufacturer technical data sheets.

This Grade

Manufacturer	科思创
Category	PC+ABS · 高流,结构泡泡
Typical Use	结构泡泡成型适合大型件

Key Properties

流不体积率	14 g/10min
密度	1.15 g/cm³
展长涵包强度	52 MPa
展长模量	2400 MPa
断裂伸长率	50%
缺口冲击(23°C)	45 kJ/m²
热变形温度(1.8 MPa)	102 °C
发泡剂	Chemical blowing agent compatible

Key Features

- 高流适合结枏泡泡成型
- 发泡后低密度
- 大型件仍具有良好刚性
- 科思创品质

Processing Conditions

流不温度	260-290 °C
模具温度	60-80 °C
干燥	4 h @ 100 °C in desiccant dryer
加工方式	Structural foam molding

Typical Applications

- 大型汽车内饰
- 大型设备外壳
- 结构板材
- 大型外壳盖

Regulatory & Compliance

- RoHS 合规
- REACH 注册

> ⚠ 所有数据来源于公开厂商目录。

Contact
Mr. Mo Hailong (莫海龙) — Business Manager · +86 138 1603 7020 · 13816037020@139.com
Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · 1st Building, 5601 Yanqian Road, Fengxian District, Shanghai

© 2026 Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · Jinsutong Reference Catalog 2026 · jinsutong.com/grades